

SANYO**三洋半導体ニュース**

No. 5257

90195

DIP30S 外形寸法変更のお知らせ

いつも三洋半導体製品をご使用いただきまして誠にありがとうございます。
 このたび 下記 三洋半導体製品の外形寸法を変更することになりましたので ご了承くださいませよう
 お願い申し上げます。

記

1. 対象機種

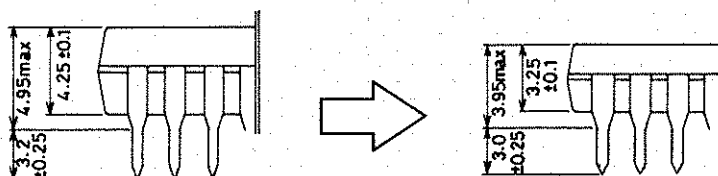
LA7083, LA7103, LA7140, LC6546N

2. 変更内容

下図の通り DIP30S パッケージの封止体の厚さ および リード寸法の一部が変更となります。
 その他の部分の変更はありません。

現 行

変 更 後



(unit: mm)

3. 変更理由

品質の向上 および 組立工程の合理化。

4. 実施時期

1995年9月初旬より 工程内自然切換えを予定しております。納入時期については 在庫状況により 多少
 遅れる場合があります。

ご不明な点については、貴社担当セールスマンにお問合せください。

以上